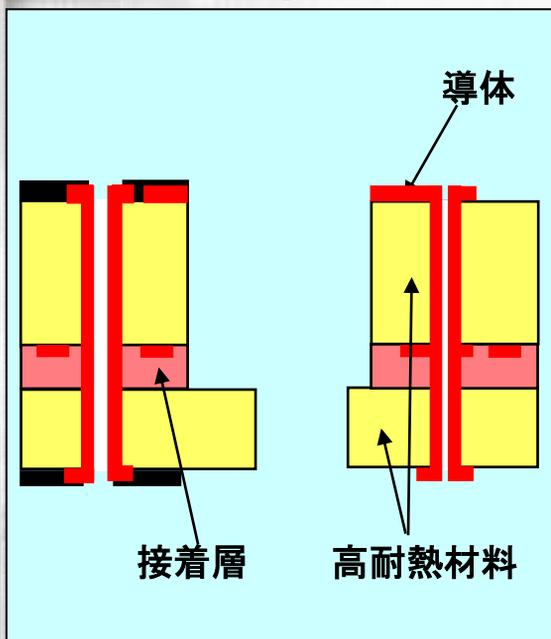


IoT対応 多層プリント配線板

キャビティタイプA



■高耐熱材料

・L-6705C(HF)

ニッカン工業株式会社製

T_g=175°C(DSC法)

低熱膨張 ハロゲンフリー

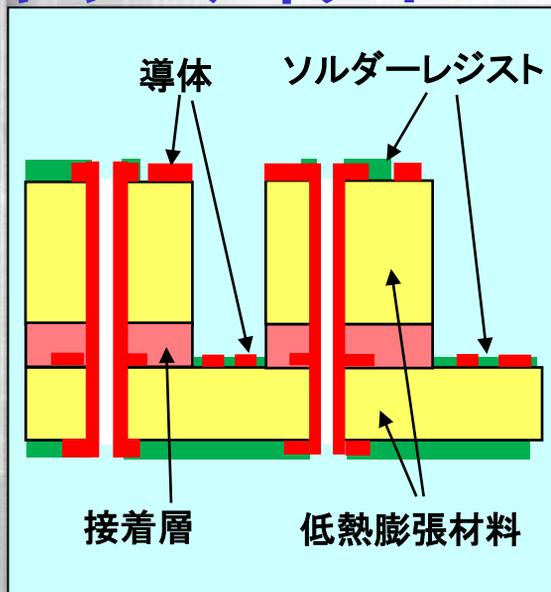
・R-1755S

パナソニック株式会社製

T_g=175°C(DSC法)

高スルーホール信頼性

キャビティタイプB



■低熱膨張高弾性率材料

・CS-3355S

T_g=155°C(DMA法)

・CS-3356S(HF)

利昌工業株式会社製

T_g=180°C(DMA法)

低熱膨張 高弾性率

■エポキシ系接着シート他

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001
認証

ISO14001
認証